

中国IC设计（芯片设计）行业发展动态及市场需求前景报告2024-2030年

产品名称	中国IC设计（芯片设计）行业发展动态及市场需求前景报告2024-2030年
公司名称	智信中科（北京）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区汤立路218号1层
联系电话	010-84825791 18311257565

产品详情

中国IC设计（芯片设计）行业发展动态及市场需求前景报告2024-2030年

【全新修订】：2024年3月

【出版机构】：中智信投研究网

【内容部分有删减·详细可参中智信投研究网出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：顾滢滢 李雪

免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员

第1章：IC设计（芯片设计）行业界定及数据统计标准说明

1.1 芯片设计的界定与战略地位分析

1.1.1 芯片设计的定义

1.1.2 芯片设计的战略地位分析

1.2 芯片设计行业术语介绍

1.3 芯片设计相关概念的界定与区分

1.4 芯片设计行业归属国民经济行业分类

1.5 本报告芯片设计行业的研究范围界定说明

1.6 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：中国芯片设计行业PEST（宏观环境）分析

2.1 中国芯片设计行业政治（Politics）环境

2.1.1 芯片设计行业监管体系及机构介绍

（1）行业主管部门

（2）行业自律组织

2.1.2 芯片设计行业标准体系建设现状

（1）标准体系建设

（2）现行标准汇总

（3）即将实施标准

（4）重点标准解读

2.1.3 芯片设计行业发展相关政策规划汇总及解读

(1) 芯片设计行业发展相关政策汇总

(2) 芯片设计行业发展相关规划汇总

2.1.4 “十四五”规划对行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对行业的影响分析

2.1.6 政策环境对行业发展的影响分析

2.2 中国芯片设计行业经济 (Economy) 环境

2.2.1 宏观经济发展现状

2.2.2 宏观经济发展展望

2.2.3 芯片设计行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国芯片设计行业社会 (Society) 环境

2.4 中国芯片设计行业技术 (Technology) 环境

2.4.1 芯片设计流程

2.4.2 芯片设计研发创新性现状

2.4.3 芯片设计行业相关专利的申请及公开情况

(1) 专利申请

(2) 专利公开

(3) 热门申请人

(4) 热门技术

2.4.4 技术环境对行业发展的影响分析

第3章：全球芯片设计行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球芯片设计行业发展历程

3.2 全球芯片设计行业发展环境

3.3 全球芯片设计行业发展现状

3.4 全球芯片设计行业市场规模测算

3.5 全球主要经济体芯片设计行业发展状况

3.5.1 美国芯片设计行业发展状况

3.5.2 德国芯片设计行业发展状况

3.5.3 日本芯片设计行业发展状况

3.5.4 其他国家/地区芯片设计行业发展状况

3.6 全球芯片设计行业市场竞争格局及兼并重组状况

3.6.1 全球芯片设计行业市场竞争状况

3.6.2 全球芯片设计企业兼并重组状况

3.7 全球芯片设计行业代表性企业发展布局案例

3.7.1 全球芯片设计行业代表性企业布局对比

3.7.2 全球芯片设计行业代表性企业布局案例

(1) 博通(AVGO.US)

(2) 高通(QCOM.US)

(3) 英伟达(NVDA.US)

(4) 联发科

(5) 美国超微公司(AMD.US)

3.8 全球芯片设计行业发展趋势及市场前景预测

3.8.1 全球芯片设计行业发展趋势预判

3.8.2 全球芯片设计行业市场前景预测

第4章：中国芯片设计产业链梳理及上游行业布局状况

4.1 中国芯片设计产业结构属性（产业链）

4.1.1 芯片设计产业链结构梳理

4.1.2 芯片设计产业链生态图谱

4.2 中国芯片设计产业价值属性（价值链）

4.2.1 芯片设计行业成本结构分析

4.2.2 芯片设计行业价值链分析

4.3 中国芯片设计上游制造材料和封装材料供应市场分析

4.3.1 芯片设计上游制造材料和封装材料概述

4.3.2 芯片设计上游制造材料和封装材料供应状况

4.3.3 芯片设计上游制造材料和封装材料供应商格局

4.3.4 芯片设计上游制造材料和封装材料价格水平

4.3.5 芯片设计上游制造材料和封装材料对行业发展的影响分析

4.4 中国芯片设计上游EDA软件供应市场分析

4.4.1 芯片设计上游EDA软件概述

4.4.2 芯片设计上游EDA软件供应状况

4.4.3 芯片设计上游EDA软件供应商格局

4.4.4 芯片设计上游EDA软件价格水平

4.4.5 芯片设计上游EDA软件对行业发展的影响分析

4.5 中国芯片设计产业链上游IP指令集市场分析

4.5.1 IP指令集概述

4.5.2 IP指令集供应状况

4.5.3 IP指令集供应商格局

4.5.4 IP指令集发展趋势

4.5.5 IP指令集对芯片设计的影响分析

第5章：中国芯片设计产业市场供需状况分析

5.1 中国芯片设计行业发展历程介绍

5.2 中国芯片设计加工制造市场特性分析

5.3 中国芯片设计产业参与者类型及规模

5.4 中国芯片设计行业参与者入场方式

5.5 中国芯片设计服务供给水平

5.6 中国芯片设计服务价格行情及走势

5.7 中国芯片设计行业市场需求分析

5.8 中国芯片设计行业市场规模测算

第6章：中国芯片设计行业竞争状况及国际竞争力分析

6.1 中国芯片设计行业波特五力模型分析

6.1.1 芯片设计行业现有竞争者之间的竞争

6.1.2 芯片设计行业关键要素的供应商议价能力分析

6.1.3 芯片设计行业消费者议价能力分析

6.1.4 芯片设计行业潜在进入者分析

6.1.5 芯片设计行业替代品风险分析

6.1.6 芯片设计行业竞争情况总结

6.2 中国芯片设计行业投融资、兼并与重组状况

6.2.1 中国芯片设计行业投融资发展状况

(1) 行业资金来源

(2) 投融资主体

(3) 投融资方式

(4) 投融资事件汇总

(5) 投融资信息汇总

(6) 投融资趋势预测

6.2.2 中国芯片设计行业兼并与重组状况

(1) 兼并与重组事件汇总

(2) 兼并与重组动因分析

(3) 兼并与重组案例分析

(4) 兼并与重组趋势预判

6.3 中国芯片设计行业市场竞争格局分析

6.4 中国芯片设计行业市场集中度分析

6.5 中国芯片设计行业海外布局状况

6.6 中国芯片设计行业国际竞争力分析

第7章：中国芯片制造行业发展状况及对芯片设计的需求分析

7.1 中国芯片制造行业发展历程

7.2 中国芯片制造行业供需状况

7.3 中国芯片制造行业市场规模

7.4 中国芯片制造行业竞争格局

7.5 中国芯片制造行业区域发展格局

7.6 中国芯片制造国产化布局现状

7.7 中国芯片设计行业国产化布局现状

第8章：中国芯片设计智能终端应用场景需求潜力分析

8.1 中国芯片设计下游应用场景结构

8.2 工业控制领域的芯片设计需求分析

8.2.1 工业控制领域智能化发展现状

8.2.2 工业控制领域芯片及芯片设计需求分析

8.3 汽车电子领域的芯片设计需求分析

8.3.1 汽车行业智能化发展现状

8.3.2 汽车领域芯片及芯片设计需求分析

8.4 电力电子领域的芯片设计需求分析

8.4.1 电力行业智能化发展现状

8.4.2 电力电子领域的芯片及芯片设计需求分析

8.5 医疗电子领域的芯片设计需求分析

8.5.1 医疗智能化发展现状

8.5.2 医疗电子领域芯片及芯片设计需求分析

8.6 通讯设备领域的芯片设计需求分析

8.6.1 通讯领域智能化发展现状

8.6.2 通讯设备领域芯片及芯片设计需求分析

8.7 其他智能终端的芯片设计需求分析

第9章：中国芯片设计行业市场痛点及竞争力提升路径

9.1 中国芯片设计行业经营效益分析

9.2 中国芯片设计行业市场痛点分析

9.3 中国芯片设计竞争力提升路径

9.4 中国芯片设计竞争力提升布局现状

第10章：中国芯片设计产业链代表性企业案例研究

10.1 中国芯片设计产业链代表性企业发展布局对比

10.2 中国芯片设计产业链代表性企业发展布局案例（排名不分先后）

10.2.1 深圳市海思半导体有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.2 紫光集团有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.3 北京豪威科技有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.4 深圳市中兴微电子技术有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.5 华大半导体有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.6 深圳市汇顶科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.7 杭州士兰微电子股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.8 北京兆易创新科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.9 北京智芯电子科技有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

10.2.10 大唐恩智浦半导体有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

(4) 企业芯片设计产业链布局状况

(5) 企业转型升级发展布局状况

(6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

第11章：中国芯片设计行业发展潜力评估及市场前景预判

11.1 中国芯片设计产业链布局诊断

11.2 中国芯片设计行业发展机遇与挑战分析

11.3 中国芯片设计行业发展潜力评估

11.4 中国芯片设计行业发展前景预测

11.5 中国芯片设计行业发展趋势预判

第12章：中国芯片设计行业投资特性及投资机会分析

12.1 中国芯片设计行业投资风险预警及防范

12.1.1 芯片设计行业政策风险及防范

12.1.2 芯片设计行业技术风险及防范

12.1.3 芯片设计行业宏观经济波动风险及防范

12.1.4 芯片设计行业关联产业风险及防范

12.1.5 芯片设计行业其他风险及防范

12.2 中国芯片设计行业市场进入壁垒分析

12.2.1 芯片设计行业人才壁垒

12.2.2 芯片设计行业技术壁垒

12.2.3 芯片设计行业资金壁垒

12.2.4 芯片设计行业其他壁垒

12.3 中国芯片设计行业投资价值评估

12.4 中国芯片设计行业投资机会分析

12.4.1 芯片设计行业产业链薄弱环节投资机会

12.4.2 芯片设计行业细分领域投资机会

12.4.3 芯片设计行业区域市场投资机会

12.4.4 芯片设计产业空白点投资机会

第13章：中国芯片设计行业投资策略与可持续发展建议

13.1 中国芯片设计行业投资策略与建议

13.2 中国芯片设计行业可持续发展建议

图表目录

图表1：本报告芯片设计齿轮箱行业研究范围界定

图表2：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表3：芯片设计行业主管部门

图表4：芯片设计行业自律组织

图表5：截至2023年芯片设计行业标准汇总

图表6：截至2023年芯片设计行业发展政策汇总

图表7：截至2023年芯片设计行业发展规划汇总

图表8：全球芯片设计行业发展趋势预判

图表9：2024-2030年芯片设计行业市场前景预测

图表10：芯片设计产业链结构

图表11：芯片设计产业链生态图谱

图表12：芯片设计上游制造材料和封装材料对行业发展的影响分析

图表13：芯片设计上游EDA软件对行业发展的影响分析

图表14：芯片设计行业生产企业

图表15：芯片设计行业现有企业的竞争分析表

图表16：芯片设计行业对上游议价能力分析表

图表17：芯片设计行业对下游议价能力分析表

图表18：芯片设计行业潜在进入者威胁分析表

图表19：中国芯片设计行业五力竞争综合分析

图表20：中国芯片设计行业市场发展痛点分析

图表21：中国芯片设计产业链代表性企业发展布局对比

图表22：深圳市海思半导体有限公司发展历程

图表23：深圳市海思半导体有限公司基本信息表

图表24：深圳市海思半导体有限公司股权穿透图

图表25：深圳市海思半导体有限公司经营状况

图表26：深圳市海思半导体有限公司整体业务架构

图表27：深圳市海思半导体有限公司销售网络布局

图表28：深圳市海思半导体有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表29：紫光集团有限公司发展历程

图表30：紫光集团有限公司基本信息表

图表31：紫光集团有限公司股权穿透图

图表32：紫光集团有限公司经营状况

图表33：紫光集团有限公司整体业务架构

图表34：紫光集团有限公司销售网络布局

图表35：紫光集团有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表36：北京豪威科技有限公司发展历程

图表37：北京豪威科技有限公司基本信息表

图表38：北京豪威科技有限公司股权穿透图

图表39：北京豪威科技有限公司经营状况

图表40：北京豪威科技有限公司整体业务架构

图表41：北京豪威科技有限公司销售网络布局

图表42：北京豪威科技有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表43：深圳市中兴微电子技术有限公司发展历程

图表44：深圳市中兴微电子科技有限公司基本信息表

图表45：深圳市中兴微电子科技有限公司股权穿透图

图表46：深圳市中兴微电子科技有限公司经营状况

图表47：深圳市中兴微电子科技有限公司整体业务架构

图表48：深圳市中兴微电子科技有限公司销售网络布局

图表49：深圳市中兴微电子科技有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表50：华大半导体有限公司发展历程

图表51：华大半导体有限公司基本信息表

图表52：华大半导体有限公司股权穿透图

图表53：华大半导体有限公司经营状况

图表54：华大半导体有限公司整体业务架构

图表55：华大半导体有限公司销售网络布局

图表56：华大半导体有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表57：深圳市汇顶科技股份有限公司发展历程

图表58：深圳市汇顶科技股份有限公司基本信息表

图表59：深圳市汇顶科技股份有限公司股权穿透图

图表60：深圳市汇顶科技股份有限公司经营状况

图表61：深圳市汇顶科技股份有限公司整体业务架构

图表62：深圳市汇顶科技股份有限公司销售网络布局

图表63：深圳市汇顶科技股份有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表64：杭州士兰微电子股份有限公司发展历程

图表65：杭州士兰微电子股份有限公司基本信息表

图表66：杭州士兰微电子股份有限公司股权穿透图

图表67：杭州士兰微电子股份有限公司经营状况

图表68：杭州士兰微电子股份有限公司整体业务架构

图表69：杭州士兰微电子股份有限公司销售网络布局

图表70：杭州士兰微电子股份有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表71：北京兆易创新科技股份有限公司发展历程

图表72：北京兆易创新科技股份有限公司基本信息表

图表73：北京兆易创新科技股份有限公司股权穿透图

图表74：北京兆易创新科技股份有限公司经营状况

图表75：北京兆易创新科技股份有限公司整体业务架构

图表76：北京兆易创新科技股份有限公司销售网络布局

图表77：北京兆易创新科技股份有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表78：北京智芯微电子科技有限公司发展历程

图表79：北京智芯微电子科技有限公司基本信息表

图表80：北京智芯微电子科技有限公司股权穿透图

图表81：北京智芯微电子科技有限公司经营状况

图表82：北京智芯微电子科技有限公司整体业务架构

图表83：北京智芯微电子科技有限公司销售网络布局

图表84：北京智芯微电子科技有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表85：大唐恩智浦半导体有限公司发展历程

图表86：大唐恩智浦半导体有限公司基本信息表

图表87：大唐恩智浦半导体有限公司股权穿透图

图表88：大唐恩智浦半导体有限公司经营状况

图表89：大唐恩智浦半导体有限公司整体业务架构

图表90：大唐恩智浦半导体有限公司销售网络布局

图表91：大唐恩智浦半导体有限公司芯片设计业务布局优劣势分析

图表92：中国芯片设计行业发展潜力评估

图表93：2024-2030年中国芯片设计行业市场前景预测

图表94：2024-2030年中国芯片设计行业市场容量/市场增长空间预测

图表95：中国芯片设计行业发展趋势预测

图表96：中国芯片设计行业市场进入与退出壁垒分析

图表97：中国芯片设计行业市场投资价值评估

图表98：中国芯片设计行业投资机会分析

图表99：中国芯片设计行业投资策略与建议

图表100：中国芯片设计行业可持续发展建议

如需完整目录请联系客服